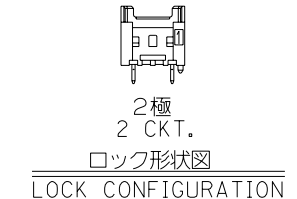
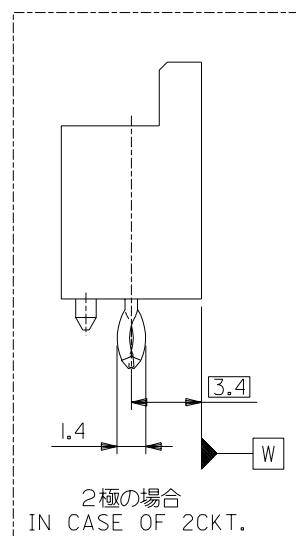
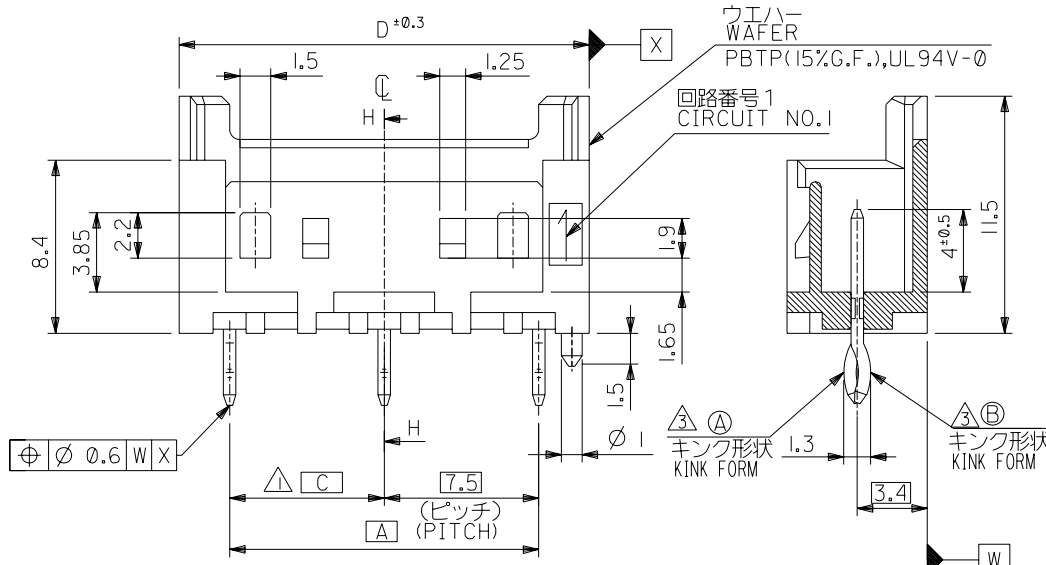


注記  
NOTES

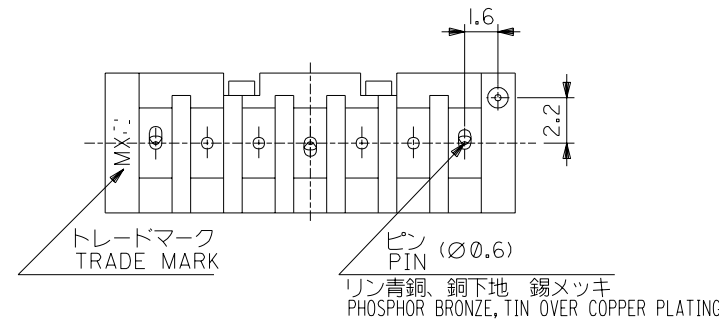
△ ウエハーの  $\phi$  から隣接するピンの  $\phi$  までの位置を示す。  
SHOW POSITION FROM  $\phi$  OF WAFER TO  $\phi$  OF ADJACENT PIN.

2. 嵌合相手: 51102, 51103 シリーズ  
MATES WITH: 51102, 51103 SERIES.

△ 3極以上のキンク形状は両サイドが (A)、その他の極はすべて (B) 形状とする。  
KINK FORM MORE THAN 2 CIRCUIT: PINS AT BOTH ENDS ARE KINK FORMED TO (A), THE OTHER PINS ARE KINK FORMED TO (B).



断面 H-H  
SECT. H-H



34.9	7.5	33.2	30	53388-0510	5
27.4	3.75	25.7	22.5	53388-0410	4
19.9	7.5	18.2	15	53388-0310	3
12.4	3.75	10.7	7.5	53388-0210	2
D	C	B	A	MATERIAL NO.	極数 NO. OF CKTS.

				材料 MATERIAL		図中参照 SEE DRAWING		MATERIAL		MOLEX-JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社	
				仕上げ FINISH		—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM		TITLE 名称	
				適用電線範囲 WIRE RANGE		—		7.5 WIRE TO BOARD CONN.		WAFER ASS'Y WITH KINK	
				被覆外径 INS. RANGE		—		-LEAD FREE-		DRAWN BY '92/12/22	
				DRAWN BY '92/12/22		CHK'D BY '93/7/16		K.TOJO		H.HIRAMOTO	
				APP'D BY '93/7/16		M.FUKUSHIMA		DR. DATE		DWG. NO.	
				M.FUKUSHIMA		SCALE 4 : 1		REV C		SD-53388-**-10	

角度 ANGLE	$\pm 3^\circ$	C	変更 REVISIED	(J2004-3573)	Y.W	04/04/05
30以上 OVER	$\pm 0.3$	B	変更 REVISIED	(J30710)	K.T	'93/7/16
10以上 OVER 30未下 UNDER	$\pm 0.25$	A	変更 REVISIED	(J30121)	K.T	'93/2/9
未下 UNDER	$\pm 0.2$	0	新規作成 RELEASED	(J20204)	K.T	'92/12/22
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD		DR. CHK.	日付 DATE